

# 募集要項

## 企業データ

<b>社名</b> DOWAホールディングス株式会社	<b>売上高 (2013年3月期)</b> 4,193億9,000万円 (連結)
<b>所在地</b> 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階	<b>経常利益 (2013年3月期)</b> 245億6,400万円 (連結)
<b>創業</b> 明治17(1884)年	<b>事業内容</b> 1. 総合環境リサイクル事業(廃棄物処理、貴金属リサイクル、汚染土壌回復) 2. 非鉄金属製錬事業 3. 電子材料事業(半導体材料、磁性材料、電子材料) 4. 金属加工事業 5. 工業炉、熱処理事業(表面処理)
<b>資本金</b> 364億3,700万円	<b>事業所</b> 本社/東京 営業所/大阪、愛知、静岡、福岡 研究所/環境技術研究所、製錬技術研究所、機能材料研究所、 半導体材料研究所、電子材料研究所、技術センター(金属加工)、 開発センター(熱処理) 工場/秋田、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、静岡、愛知、岡山、 福岡、熊本 海外/中国、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、インド、 アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、チェコ
<b>代表者</b> 代表取締役社長 山田 政雄	
<b>従業員数 (2013年4月現在)</b> 5,499名 (連結)	

## 採用データ

<b>採用予定数</b> 技術系：30名 事務系：10名	<b>初任給 (2013年4月実績)</b> 修士了：239,000円 学部卒：215,000円 高専卒：186,500円
<b>職種</b> 技術系/研究開発、製造、生産技術開発、プラント設計・保守 生産管理、品質管理 事務系/企画、営業、経理、人事、労務、総務、法務	<b>諸手当</b> 通勤費(全額支給)、超過勤務手当、住宅手当 ほか
<b>勤務時間</b> 本社/9:00~17:25(フレックスタイム制) 事業所/8:00~16:00ほか(勤務地による)	<b>昇給・賞与</b> 昇給：年1回(4月) 賞与：年2回(6月、12月)
<b>勤務予定地</b> 全国各地(本社、営業所、研究所、工場)、海外	<b>寮・社宅</b> 完備(本社、営業所、研究所、工場などの勤務地周辺)
	<b>休日・休暇</b> 週休2日、祝祭日、メーデー、創立記念日、年末年始、 有給休暇(10~22日)、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇 ほか

## 応募について

<b>選考方法</b> 面接、適性検査	<b>提出書類</b> 1. 技術系 (1) 学科推薦 学科推薦書、当社指定履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 (院生の方は、学部時の成績証明書、卒業証明書も提出) 現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出 (2) 自由応募 エントリーシート 現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出 2. 事務系 エントリーシート
<b>試験日</b> 4月1日より順次実施	<b>書類提出先</b> 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階 DOWAホールディングス株式会社 人事・人材開発部門 部長 稲葉 修 宛
<b>交通費</b> 当社規定により支給	
<b>応募方法</b> 1. 学科推薦(技術系応募のみ受付) 応募提出書類を揃え、ご郵送ください 2. 自由応募 採用ホームページ上でご応募ください URL： <a href="http://www.dowa.co.jp/saiyou/">http://www.dowa.co.jp/saiyou/</a>	

担当：今元・光  
TEL：0120-268862(フリーダイヤル)/03-6847-1102(直通)  
E-Mail：[saiyou@dowa.co.jp](mailto:saiyou@dowa.co.jp)

**DOWAホールディングス株式会社**